

## 概 要

本概要旨在為閣下提供本文件所載資料的概覽。由於其為概要，並不包含對閣下而言可能屬重要的所有資料。閣下決定[編纂][編纂]前，應細閱本文件全文。

任何[編纂]均存在風險。部分有關[編纂][編纂]的特定風險載於「風險因素」一節。閣下在決定投資[編纂]前，應細閱該章節。

### 概覽

#### 我們是誰

我們是一家中國領先的智能半導體傳輸系統本土提供商，也是國內唯一能夠提供規模化全流程智能半導體傳輸系統的本土企業。我們遵循中國促進半導體設備國產化替代的國家產業政策，採用一體化經營模式，專注於為半導體前道設備製造商及晶圓廠研發、製造及銷售晶圓傳輸設備(包括設備前端晶圓傳輸模塊(EFEM)、晶圓分選機(Sorter)及相關零部件)及自動物料搬運系統(AMHS)。根據弗若斯特沙利文的資料，按收入計，我們在中國2025年智能半導體傳輸系統市場及晶圓傳輸設備市場均位列國內企業第二，市場份額分別為2.7%及6.3%。按收入計，我們亦在中國2025年12英寸晶圓製造領域晶圓傳輸設備市場位居國內企業首位，市場份額為7.8%。此外，我們為半導體後道製造商生產及銷售半導體封裝自動化設備，並為晶圓廠及半導體設備製造商提供技術服務。

#### 業務模式

我們採用一體化經營模式，以研發、製造和銷售半導體製造設施所需的智能半導體傳輸系統及相關部件為核心，輔以技術服務。自公司成立以來，我們一直專注於讓先進半導體製造中的晶圓傳輸過程更為精準、潔淨且高效。我們透過銷售設備、部件及技術服務產生收入。2023年12月，我們收購了一家馬來西亞公司Waftech，該公司從事半導體封裝自動化設備的研發、製造及銷售。Waftech擁有成熟的國際銷售網絡，為多個國家和地區半導體製造商提供服務。此項收購使我們產品線拓展至半導體價值鏈的後端領域，並提升我們服務國際客戶的能力。有關進一步詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構 – 主要收購、出售及合併 – 收購Waftech」。

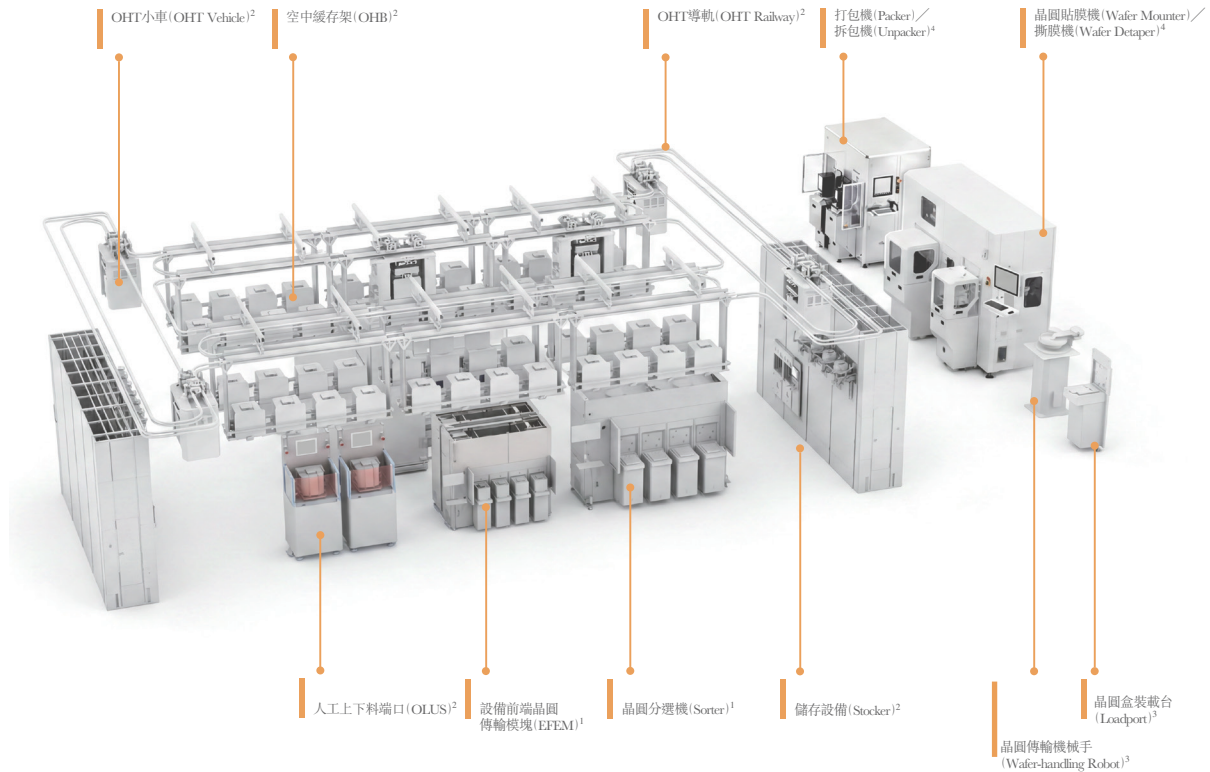
我們的產品及服務對半導體製造前道及後道工序的多個環節至關重要，這讓我們與半導體價值鏈中的重要利益相關方建立了緊密聯結。在前道工序方面，我們主要為半導體設備製造商及晶圓廠從事(i)晶圓傳輸設備(包括設備前端晶圓傳輸模塊(EFEM)、晶圓分選機(Sorter)及相關零部件)及(ii)自動物料搬運系統(AMHS)的研發、生產及銷售。在後道工序方面，我們主要為半導體後道製造商生產及銷售半導體封裝自動化設備。我們亦為晶圓廠及半導體設備製造商提供維修和保養等技術服務，並銷售零部件。

請參閱「業務 – 業務模式」。

## 概 要

### 我們的產品及服務

下圖展示了我們的產品組合：



附註：

- (1) 設備前端晶圓傳輸模塊(EFEM)及晶圓分選機(Sorter)為我們的主要晶圓傳輸設備。
- (2) 我們的自動物料搬運系統(AMHS)主要包括OHT小車、OHT導軌、空中緩存架(OHB)、儲存設備(Stocker)、人工上下料端口(OLUS)以及其他支持硬件和軟件。
- (3) 晶圓傳輸機械手及晶圓盒裝載台(Loadport)為我們的設備前端晶圓傳輸模塊(EFEM)及晶圓分選機(Sorter)的主要零部件。
- (4) 打包機、拆包機、晶圓貼膜機及晶圓撕膜機為我們的半導體封裝自動化設備。

我們為客戶提供從獨立晶圓傳輸設備到自動物料搬運系統(AMHS)的軟硬一體智能半導體傳輸系統。我們亦為晶圓廠及半導體設備製造商提供技術服務。

我們的產品及服務詳情載列如下：

#### 晶圓傳輸設備

- 設備前端晶圓傳輸模塊(EFEM)：集成在半導體製造設備中的子系統，在受控的微環境中提供晶圓裝載、對準和傳輸功能。
- 晶圓分選機(Sorter)：一種自動化系統，處理、分選、對齊、識別以及在晶圓載具之間傳輸晶圓以確保正確朝向及按正確順序放置。

#### 自動物料搬運系統(AMHS)

自動物料搬運系統(AMHS)是一種智能半導體傳輸系統，主要由OHT小車、OHT導軌、空中緩存架(OHB)、儲存設備(Stocker)及人工上下料端口(OLUS)組成，並配備周邊設備及軟件系統，實現晶圓載具的自動化運輸、存儲和配送，從而提高物料流動並減少人工搬運。

## 概 要

### 半導體封裝自動化設備

我們的半導體封裝自動化設備主要包括打包機、拆包機、晶圓貼膜機及晶圓撕膜機，為半導體封裝自動化提供支持。

### 技術服務及其他

我們提供半導體製造設備的安裝、維修和保養服務，側重於前道工序過程中使用的蝕刻和量測設備。

### 智能控制軟件

我們自主研發設備前端晶圓傳輸模塊(EFEM)、晶圓分選機(Sorter)、自動物料搬運系統(AMHS)及彼等各自關鍵零部件的智能控制軟件。我們將軟硬件作為整合方案進行銷售。

請參閱「業務 – 我們的產品及服務」。

### 我們的市場機遇

受半導體製造業高速發展帶動，中國智能半導體傳輸系統市場持續增長，而晶圓製造商對自動化、數字化、效率、潔淨度控制及物流穩定性的需求日增，亦為其市場發展奠定基礎。AI應用的發展，連同其他因素，進一步推動晶圓廠對更高品質及效率的需求上升。智能半導體傳輸系統是指在半導體製造全流程中，實現晶圓從晶圓廠車間到設備級微環境間高效、潔淨度控制、智能化流轉的綜合自動化平台。智能半導體傳輸系統主要包括晶圓傳輸設備及自動物料搬運系統(AMHS)。

中國智能半導體傳輸系統市場規模在2021–2025年間實現高速增長。市場規模由2021年的人民幣70億元增長至2025年的人民幣146億元，對應年複合增長率為20.2%。隨著行業從新建產能擴張階段，邁入穩步擴容與結構性提效並行的發展階段，需求預計將推動系統升級與智能化運維改造；同時，AI在生產調度優化、設備狀態監控與預測性維護等場景的應用深化，有望進一步提升智能傳輸系統的功能。中國半導體智能傳輸系統市場規模預計將以約13.4%的年複合增長率持續增長，預計由2026年的人民幣164億元增長至2030年的人民幣272億元。

### 競爭

中國的半導體智能傳輸系統市場競爭激烈。國際領先企業目前主導市場，而本土企業正迅速崛起。我們面對來自擁有成熟技術棧及生態系統優勢的國際成熟企業的激烈競爭，同時也應對其他針對相同市場分部的本土競爭者的挑戰。國內對技術替代方案的需求不斷增加，加之工藝製程快速演進，為我們帶來機遇與挑戰。請參閱「行業概覽」。

### 我們的競爭優勢

我們相信以下競爭優勢有助於我們的成功：

- 我們是中國領先的智能半導體傳輸系統提供商；
- 堅持技術創新和自主研發，構建核心技術壁壘；
- 產品矩陣覆蓋晶圓傳輸全流程，精準匹配多元客戶需求；
- 核心產品的性能達到國際一流水平；
- 以客戶為中心，深度覆蓋行業頭部客戶；及
- 極具戰略眼光、富有經驗的管理團隊。

## 概 要

### 我們的發展戰略

我們將專注於下列關鍵戰略以驅動我們的未來增長：

- 持續研發投入，打造半導體智能傳輸平台；
- 夯實人才基礎；
- 加速推進全球化佈局；
- 推進戰略投資及收購；及
- 深化研發及產業化垂直整合。

### 研發

我們的研發能力是維持我們市場領先地位及推動長期增長的基礎。通過專注於核心技術的自主研發，我們能夠迅速響應晶圓製造不斷演變的需要。

於往績記錄期間，我們持續對研發進行大量投入。於2023年、2024年及2025年，我們的研發開支分別為人民幣41.4百萬元、人民幣59.6百萬元及人民幣47.1百萬元，分別佔我們各年度總收入的31.0%、19.3%及9.0%。上述研發投入支持我們核心技術的持續升級及業務的持續增長。

我們擁有一支穩定且經驗豐富的技術團隊，為研發工作提供堅實支撐。截至2025年12月31日，我們擁有145名經驗豐富的技術專業人員，佔我們總人數的27.7%。我們的多名研發人員為資深半導體相關工程師，在技術和材料創新方面具備深厚專長。

於往績記錄期間，我們開展多項與設備前端晶圓傳輸模塊(EFEM)、自動物料搬運系統(AMHS)及其關鍵組件有關的研發項目，以適配最新晶圓製造技術。

請參閱「業務 – 研發 – 主要研發項目」。

### 製造

我們分別在中國運營兩個生產基地及在馬來西亞運營一個生產基地，專責生產智能半導體傳輸系統及半導體封裝自動化設備。截至2025年12月31日，我們的生產基地總建築面積為59,794平方米。我們的製造運營整合數字化流程及實時監控系統，旨在增強工藝精度、保持生產穩定性，實現規模化成本效益。

請參閱「業務 – 製造」。

### 銷售與營銷

我們通過直銷模式建立了廣泛的銷售及客戶網絡。銷售及營銷活動主要由內部團隊負責，通過商務拜訪、現場評估、商務談判、招標流程以及行業展覽和會議等方式與客戶接洽。

於往績記錄期間，我們的收入來源於向客戶的直接銷售。於2023年12月收購Waftech後，我們借助Waftech成熟的國際銷售網絡進一步拓展海外業務佈局，將客戶覆蓋範圍延伸至中國內地以外市場。

請參閱「業務 – 銷售與營銷」。

## 概 要

### 我們的客戶

我們的客戶主要包括半導體製造設備公司、IDM公司和晶圓廠，我們一般直接與其建立合作關係。於2023年、2024年及2025年，我們來自前五大客戶的總收入分別為人民幣80.2百萬元、人民幣261.3百萬元及人民幣361.2百萬元，分別佔我們總收入的60.1%、84.6%及69.3%。於相同年度，我們各年度來自最大客戶的收益分別為人民幣24.1百萬元、人民幣183.3百萬元及人民幣207.8百萬元，分別佔我們總收益的18.1%、59.4%及39.8%。

請參閱「業務 – 我們的客戶」。

### 我們的供應商

我們的供應商主要包括用於產品製造的原材料及其他組件的供應商。於2023年、2024年及2025年，我們向各年度前五大供應商作出的採購金額分別為人民幣59.8百萬元、人民幣159.4百萬元及人民幣187.2百萬元，分別佔總採購額的57.0%、57.8%及53.3%。於相同年度，我們於各年度向單一最大供應商作出的採購金額分別為人民幣23.4百萬元、人民幣78.2百萬元及人民幣87.3百萬元，分別佔總採購額的22.3%、28.4%及24.8%。

請參閱「業務 – 我們的供應商」。

### 風險因素

我們的業務及經營涉及本文件「風險因素」一節所載若干風險及不確定因素。閣下在決定投資我們的H股前，應細閱該章節全文。該等風險包括(其中包括)以下各項：

- 我們所處行業的特徵是技術變革迅速及市場需求不斷演變。未能跟上技術創新、不斷變化的客戶需求或行業發展，均可能對我們的競爭力及業務造成不利影響；
- 我們所經營的行業競爭激烈。倘我們未能有效地與其他市場參與者競爭，則我們的業務、財務狀況及經營業績可能受到不利影響；
- 我們依賴半導體行業的增長。半導體行業增長的任何放緩均可能對我們的業務、財務狀況及經營業績造成不利影響；
- 我們的歷史業績未必代表我們的未來表現，我們可能無法成功擴大業務或管理我們的增長；及
- 倘我們無法維持現有客戶或吸引新客戶，我們的業務、財務狀況及經營業績可能會受到重大不利影響。

### 控股股東

截至最後實際可行日期，董事會主席、執行董事兼首席執行官Ye女士透過寧波矽藍、上海仕芯、上海竺世及上海皓棠有權行使本公司約54.74%之投票權。

緊隨股份拆細及[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)，Ye女士將通過寧波矽藍、上海仕芯、上海竺世及上海皓棠控制我們經擴大股本總投票權約[編纂]。因此，於[編纂]完成後，Ye女士、寧波矽藍、上海仕芯、上海竺世及上海皓棠將構成一組控股股東。

## 概 要

### 歷史財務資料概要

歷史財務資料概要應與本文件附錄一會計師報告綜合財務報表，包括本文件「財務資料」所載隨附附註及資料一併閱讀。

### 綜合損益表概要

下表載列於所示年度我們的綜合損益表選定項目：

	截至12月31日止年度		
	2023年	2024年	2025年
	(人民幣千元)		
收入 .....	<b>133,289</b>	<b>308,925</b>	<b>521,511</b>
銷售成本.....	(97,552)	(217,431)	(364,745)
<b>毛利 .....</b>	<b>35,737</b>	<b>91,494</b>	<b>156,766</b>
其他淨收入.....	2,748	9,330	7,018
銷售及營銷開支.....	(11,677)	(20,429)	(30,832)
行政開支.....	(47,510)	(53,711)	(66,909)
研發開支.....	(41,375)	(59,594)	(47,139)
貿易應收款項的減值虧損.....	(215)	(1,056)	(1,484)
<b>經營(虧損)/利潤 .....</b>	<b>(62,292)</b>	<b>(33,966)</b>	<b>17,420</b>
附帶贖回權普通股的 賬面值變動.....	(16,355)	(20,160)	(22,855)
其他融資成本.....	(4,025)	(7,407)	(9,533)
融資成本.....	(20,380)	(27,567)	(32,388)
<b>除稅前虧損.....</b>	<b>(82,672)</b>	<b>(61,533)</b>	<b>(14,968)</b>
所得稅 .....	852	(2,055)	2,238
<b>年內虧損.....</b>	<b>(81,820)</b>	<b>(63,588)</b>	<b>(12,730)</b>
<b>以下各項應佔：</b>			
- 本公司權益股東.....	(81,819)	(61,603)	(11,101)
- 非控股權益 .....	(1)	(1,985)	(1,629)

## 概 要

### 非國際財務報告準則計量

為補充我們按照國際財務報告準則會計準則呈列的綜合財務報表，我們亦使用年內經調整溢利／(虧損)(非國際財務報告準則計量)作為一項額外財務計量，該計量並非國際財務報告準則會計準則所規定，亦非按國際財務報告準則會計準則呈列。

下表將我們按照國際財務報告準則會計準則呈列的年內溢利／(虧損)與年內經調整溢利／(虧損)(非國際財務報告準則計量)進行對賬：

	截至12月31日止年度		
	2023年	2024年	2025年
		(人民幣千元)	
年內虧損.....	(81,820)	(63,588)	(12,730)
加：			
附帶贖回權普通股的			
賬面值變動.....	16,355	20,160	22,855
股份支付費用.....	17,414	3,199	2,402
[編纂]開支.....	—	—	1,295
年內經調整溢利／(虧損)(非國際財 務報告準則計量).....	<u>(48,051)</u>	<u>(40,229)</u>	<u>13,822</u>

我們將年內經調整溢利／(虧損)(非國際財務報告準則計量)界定為年內虧損，不包括附帶贖回權普通股的賬面值變動、股份支付費用及[編纂]開支。我們不計入該等項目，原因為彼等預期並無產生未來現金付款。特別是：

- (i) 附帶贖回權普通股的賬面值變動屬非現金性質，附帶贖回權普通股將於[編纂]完成後自動轉換為本公司股權；
- (ii) 股份支付費用與我們授予僱員、非僱員顧問及董事的股份獎勵有關且屬非現金性質；及
- (iii) [編纂]開支與本次[編纂]有關。

我們認為，年內經調整溢利／(虧損)(非國際財務報告準則計量)以與其幫助管理層相同的方式，為投資者及其他人士理解及評估我們的綜合經營業績提供有用資料。然而，我們的非國際財務報告準則計量並無國際財務報告準則會計準則規定的標準涵義，且我們呈報的年內經調整溢利／(虧損)(非國際財務報告準則計量)可能與其他公司呈報的類似標題計量不可比較。使用年內經調整溢利／(虧損)(非國際財務報告準則計量)作為分析工具有其局限性，閣下不應將其與根據國際財務報告準則會計準則呈報的經營業績或財務狀況分析分開考慮，或將其視為替代分析。

## 概 要

### 收入

下表載列於所示年度我們按產品及服務類型劃分的收入明細：

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
	(人民幣千元，百分比除外)					
智能半導體傳輸系統 .....	106,632	80.0	243,252	78.7	407,253	78.1
– 晶圓傳輸設備 <sup>(1)</sup> .....	104,953	78.7	239,226	77.4	380,453	73.0
– 自動物料搬運系統(AMHS) <sup>(2)</sup> ...	–	–	–	–	13,423	2.6
– 零部件及其他 <sup>(3)</sup> .....	1,679	1.3	4,026	1.3	13,377	2.5
半導體封裝自動化設備及組件 <sup>(4)</sup> ...	3,848	2.9	13,198	4.3	44,304	8.5
技術服務及其他 <sup>(5)</sup> .....	22,809	17.1	52,475	17.0	69,954	13.4
<b>總計 .....</b>	<b>133,289</b>	<b>100.0</b>	<b>308,925</b>	<b>100.0</b>	<b>521,511</b>	<b>100.0</b>

附註：

- (1) 包括銷售設備前端晶圓傳輸模塊(EFEM)及晶圓分選機(Sorter)的收入。
- (2) 我們於2025年12月開始自銷售自動物料搬運系統(AMHS)獲得收入。
- (3) 主要包括與智能半導體傳輸系統相關的零部件銷售收入，例如晶圓盒裝載台(Loadport)、晶圓傳輸機械手、片叉、氮氣填充裝置及E84傳感器。
- (4) 半導體封裝自動化設備及組件銷售收入均產自我們的馬來西亞附屬公司Waftech。我們已於2023年12月完成對Waftech的收購。請參閱「歷史、發展及公司架構 – 主要收購、出售及合併 – 收購Waftech」。
- (5) 包括為半導體設備製造商提供維修和保養服務以及銷售相關組件的收入。

我們的收入於往績記錄期間保持穩步增長。於2023年、2024年以及2025年，我們錄得收入分別為人民幣133.3百萬元、人民幣308.9百萬元及人民幣521.5百萬元。

## 概 要

### 毛利及毛利率

下表載列於所示年度我們按產品及服務類型劃分的毛利及毛利率明細：

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	毛利	毛利率(%)	毛利	毛利率(%)	毛利	毛利率(%)
	(人民幣千元，百分比除外)					
智能半導體傳輸系統 .....	23,319	21.9	63,487	26.1	117,268	28.8
– 晶圓傳輸設備 .....	22,301	21.2	62,254	26.0	106,195	27.9
– 自動物料搬運系統(AMHS) ....	–	–	–	–	5,029	37.5
– 零部件及其他 .....	1,018	60.6	1,233	30.6	6,044	45.2
半導體封裝自動化設備及組件 .....	2,014	52.3	6,299	47.7	16,091	36.3
技術服務及其他 .....	10,404	45.6	21,708	41.4	23,407	33.5
<b>總計 .....</b>	<b>35,737</b>	<b>26.8</b>	<b>91,494</b>	<b>29.6</b>	<b>156,766</b>	<b>30.1</b>

### 綜合財務狀況表概要

	於12月31日		
	2023年	2024年	2025年
	(人民幣千元)		
非流動資產總額 .....	184,502	245,487	326,627
流動資產總額 .....	324,848	391,984	550,390
<b>總資產 .....</b>	<b>509,350</b>	<b>637,471</b>	<b>877,017</b>
非流動負債總額 .....	57,838	116,504	124,273
流動負債總額 .....	571,308	699,333	920,761
<b>總負債 .....</b>	<b>629,146</b>	<b>815,837</b>	<b>1,045,034</b>
<b>流動負債淨值 .....</b>	<b>(246,460)</b>	<b>(307,349)</b>	<b>(370,371)</b>
<b>負債淨額 .....</b>	<b>(119,796)</b>	<b>(178,366)</b>	<b>(168,017)</b>

我們的流動負債淨額由2024年12月31日的人民幣307.3百萬元增加至2025年12月31日的人民幣370.4百萬元，主要由於(i)附帶贖回權普通股增加人民幣122.9百萬元；(ii)貿易及其他應付款項增加人民幣53.9百萬元；及(iii)計息借款增加人民幣47.2百萬元，部分被(i)現金及現金等價物增加人民幣77.4百萬元；(ii)存貨及合同履約成本增加人民幣52.2百萬元；及(iii)貿易及其他應收款項增加人民幣51.9百萬元所抵銷。

## 概 要

我們的流動負債淨額由2023年12月31日的人民幣246.5百萬元增加至2024年12月31日的人民幣307.3百萬元，主要由於(i)貿易及其他應付款項增加人民幣102.8百萬元；(ii)附帶贖回權普通股增加人民幣20.2百萬元，部分被(i)存貨及合同履約成本增加人民幣68.5百萬元及(ii)貿易及其他應收款項增加人民幣52.5百萬元所抵銷。

有關更多資料，請參閱「財務資料 – 綜合財務狀況表選定項目討論」。

於往績記錄期間，我們將附帶贖回權普通股確認為金融負債。於[編纂]後，[編纂]前投資者贖回權的終止將導致普通股由負債重新分類為權益。請參閱本文件「財務資料 – 債務 – 附帶贖回權普通股」及附錄一會計師報告附註23。

### 綜合現金流量表概要

下表載列於所示年度我們現金流量資料的概要：

	截至12月31日止年度		
	2023年	2024年	2025年
	(人民幣千元)		
經營活動(所用)／所得現金流量			
淨額	(76,329)	(25,340)	1,024
投資活動(所用)現金流量淨額	(116,421)	(62,092)	(62,983)
融資活動所得現金流量淨額	204,789	46,535	139,272
現金及現金等價物			
增加／(減少)淨額	12,039	(40,897)	77,313
年初現金及現金等價物	44,387	56,518	15,839
匯率變動影響	92	218	118
年末現金及現金等價物	56,518	15,839	93,270

### 主要財務比率

下表載列截至所示日期／年度我們的主要財務比率：

	截至12月31日／截至該日止年度		
	2023年	2024年	2025年
收入增長率 <sup>(1)</sup>	不適用	131.8%	68.8%
毛利率 <sup>(2)</sup>	26.8%	29.6%	30.1%
流動比率 <sup>(3)</sup>	0.57	0.56	0.60

附註：

- (1) 收入增長率等於我們總收入的增長額除以上一年度總收入再乘以100%。
- (2) 毛利率按年內毛利除以年內總收入，再乘以100%計算。
- (3) 流動比率按相關日期的流動資產總額除以流動負債總額計算。

## 概 要

### 股息及股息政策

於往績記錄期間，本公司概無派付或宣派任何股息。未來任何股息的宣派及派付將由董事會釐定，並須遵守我們的組織章程細則及中國公司法，且將視乎多項因素，包括我們的財務表現及業務營運以及資本需求。除非股息是從我們合法可供分派的利潤及儲備中撥付，否則不得宣派或派付任何股息。誠如我們的中國法律顧問所確認，根據中國法律，我們未來產生的任何淨利潤須先用於彌補過往累計虧損，其後我們須撥付不少於淨利潤的10%至法定公積金，直至公積金累計總額達到註冊資本的50%以上。因此，我們僅可在(i)所有過往財政年度的過往累計虧損已彌補；及(ii)我們已按上述規定將足夠的淨利潤撥付至法定公積金後，方有能力宣派股息。

目前，我們無意於[編纂]後採納正式股息政策或設定固定股息分派比率。

### [編纂]用途

按每股[編纂][編纂]港元的[編纂]，經扣除我們就[編纂]應付的[編纂]費用及[編纂]以及估計開支後，我們估計將自[編纂]收取[編纂]約人民幣[編纂]百萬元(相當於約[編纂]百萬港元)。我們擬將[編纂]作如下用途：

- 約[編纂]，或人民幣[編纂]百萬元，將用於研發及技術創新；
- 約[編纂]，或人民幣[編纂]百萬元，將用於提升產能；
- 約[編纂]，或人民幣[編纂]百萬元，將用於進行併購及戰略投資，以實現我們的長期增長策略；及
- 約[編纂]，或人民幣[編纂]百萬元，將用作營運資金及其他一般企業用途。

[編纂]

## 概 要

[編纂]

### [編纂]開支

我們的[編纂]開支包括就[編纂]產生的專業費用、[編纂]及其他費用。按[編纂]每股[編纂]港元計算，我們與[編纂]有關的[編纂]開支估計約為人民幣[編纂]百萬元([編纂]百萬港元)，佔[編纂]的[編纂]%。[編纂]開支包括(i)[編纂]相關開支(包括[編纂])約人民幣[編纂]百萬元([編纂]百萬港元)，及(ii)非[編纂]相關開支約人民幣[編纂]百萬元([編纂]百萬港元)，包括(a)我們的法律顧問及申報會計師費用及開支約人民幣[編纂]百萬元([編纂]百萬港元)，及(b)其他費用及開支約人民幣[編纂]百萬元([編纂]百萬港元)。

於往績記錄期間，我們產生[編纂]開支人民幣[編纂]百萬元([編纂]百萬港元)，其中人民幣[編纂]百萬元([編纂]百萬港元)已於綜合損益表列支，而人民幣[編纂]百萬元([編纂]百萬港元)則歸屬於發行股份並將自權益扣除。我們預期於往績記錄期間後將產生額外[編纂]開支約人民幣[編纂]百萬元([編纂]百萬港元)，其中約人民幣[編纂]百萬元([編纂]百萬港元)預期將於綜合損益表列支，而約人民幣[編纂]百萬元([編纂]百萬港元)歸屬於[編纂]股份並將於[編纂]時自權益扣除。上述[編纂]開支為最近期可行估計，僅供參考，實際金額可能與此估計有所不同。

### 上市規則規定的披露

董事確認，截至最後實際可行日期，股份於聯交所[編纂]後，概無任何情況會導致上市規則第13章第13.13至13.19條作出披露。

### 近期發展

我們的業務於往績記錄期間後直至最後實際可行日期持續發展。我們在研發適配先進封裝技術(PLP)的晶圓分選機(Sorter)方面取得技術突破，並已開始向客戶交付該等產品。憑藉此項技術突破，我們進一步強化了滲透現有市場及開拓新市場機會的能力。自2026年1月1日至最後實際可行日期，我們獲得16名新客戶，主要包括晶圓廠及半導體設備製造商。

### 無重大不利變動

董事確認，直至本文件日期，自2025年12月31日(即本文件附錄一會計師報告所載本集團最近期經審核綜合財務狀況表日期)起，我們的商業模式以及經營所在總體經濟和監管環境未發生重大變化，且我們的財務或交易狀況或前景亦未發生重大不利變動。